



2024年3月期 第3四半期

(2023年4月1日 ~ 2023年12月31日)

# 決算補足資料

**ENOMOTO Co.,Ltd.**

東証プライム 証券コード:6928

- (1) 2024年3月期決算第3四半期決算 P.3
- (2) 2024年3月期業績予想 P.10

# (1)2024年3月期第3四半期決算



- ・ 自動車向けの需要が比較的堅調に推移している一方、中国市場の低迷や欧米の長期化するインフレから民生用機器(スマートフォンなどを含む)向けや産業用機器向けを中心に在庫調整が継続
- ・ 年末にかけて円高が進行したことで、外貨建て資産の評価に掛かる為替影響は差損に
- ・ 生産能力増強に伴う減価償却費や人財の採用などの先行投資により、営業利益は大幅減益

単位:百万円	2023/3期 3Q累計		2024/3期 3Q累計		期比較	
	実績	売上比(%)	実績	売上比(%)	前同比(%)	前同比増減
売上高	22,690	100.0	19,190	100.0	△15.4	△3,500
売上総利益	3,404	15.0	2,095	10.9	△38.4	△1,308
販管費	1,889	8.3	1,854	9.7	△1.9	△35
営業利益	1,514	6.7	240	1.3	△84.1	△1,273
為替差損益	57	-	△12	-	-	△69
経常利益	1,644	7.2	279	1.5	△83.0	△1,365
四半期純利益	1,211	5.3	117	0.6	△90.3	△1,094

- 需要の全体的な回復は来期へ後倒しとなり、売上高は前四半期比6%減収
- 材料費率の高い従来品のリードフレームが減少したことで売上高は減少したが、付加価値率の高いクリップボンディングタイプのリードフレームや、マイクロコネクタの構成比増加によって利益は改善

単位:百万円	2023/3期					2024/3期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	前同比	2Q比
売上高	7,243	7,406	8,040	6,574	29,265	6,426	6,593	6,169	△23.3	△6.4
売上総利益	1,155	1,017	1,231	695	4,100	722	642	730	△40.7	+13.7
販管費	619	615	655	648	2,538	590	637	626	△4.3	△1.7
営業利益	536	401	575	46	1,561	132	4	103	△82.0	+2,109.9
為替差損益	84	53	△80	△20	37	12	16	△41	-	-
経常利益	638	489	516	161	1,805	162	27	89	△82.7	+222.5
四半期純利益	431	346	433	57	1,269	96	△9	29	△93.1	-

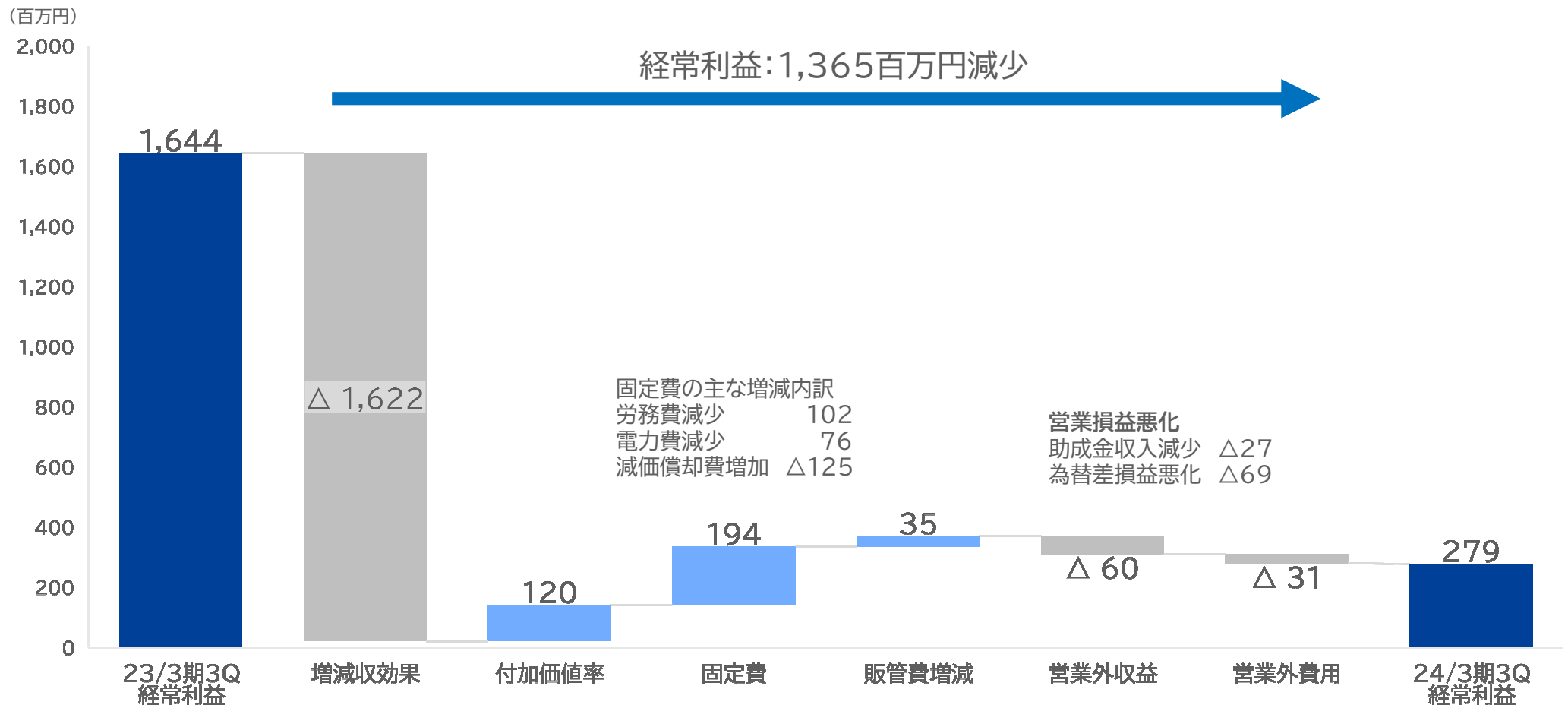
- ・ パワー半導体用リードフレームは、自動車向けは堅調の一方、民生・産機向けは在庫調整が継続
- ・ オプト用リードフレームは、北米を中心に大型ディスプレイ向けが低迷が続き、前四半期並み
- ・ コネクタ用部品はスマートフォン向け、ウェアラブル向け共に在庫調整局面。車載(エアバッグ等)向けは回復

単位:百万円	2023/3期					2024/3期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	前同比	2Q比
パワー半導体用 リードフレーム	2,684	2,797	3,377	3,113	11,973	3,164	2,832	<b>2,516</b>	△25.5%	△11.1%
オプト用 リードフレーム	1,008	931	854	925	3,719	712	662	<b>648</b>	△24.1%	△2.1%
コネクタ用部品	3,408	3,496	3,627	2,379	12,912	2,437	2,970	<b>2,863</b>	△21.1%	△3.6%
その他	143	180	180	155	659	112	129	<b>141</b>	△21.7%	+9.3%
合計	7,243	7,406	8,040	6,574	29,265	6,426	6,593	<b>6,169</b>	△23.3%	△6.4%

- 増減収効果
- 付加価値率
- 固定費

パワー半導体用リードフレームの調整、コネクタ部品とオプト用リードフレームも大幅減少  
クリップボンディングリードフレームとマイクロコネクタの増加により製品ミックスは改善

- ① 生産能力増強に伴う減価償却費増加
- ② 稼働率低下により人件費減少
- ③ 電力費は再エネ利用増と稼働率低下により減少



- ・ 車載はパワー半導体用リードフレームが堅調、エアバッグ向けコネクタ等も回復
- ・ スマートフォンは前期4Qからの調整が続き、ウェアラブルも在庫調整継続
- ・ 民生・産機・その他はデータセンター向け等のパワー半導体用が調整、大型ディスプレイ向けのLEDも低迷

## 民生・産機・その他

- ・ 構成比は前期の33.9%から 5.0pt減少  
前年同期比18.0%減少
- ・ データセンター向け、産機向けのパワー半導体用  
リードフレームが在庫調整
- ・ 大型ディスプレイ向けのLED用リードフレームが  
減少

## ウェアラブル

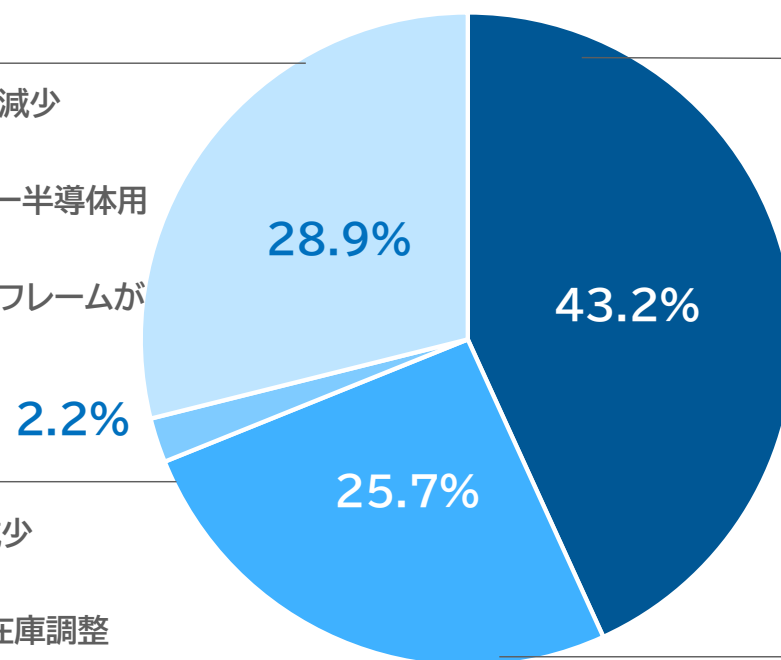
- ・ 構成比は前期の5.1%から 2.9pt減少  
前年同期比65.1%減少
- ・ ワイヤレスイヤホンやウォッチ向けの在庫調整

## 車載

- ・ 構成比は前年同期の32.6%から 10.6pt増加  
前年同期比8.5%増加
- ・ xEV向けパワー半導体用リードフレームが好調
- ・ エアバッグ向けコネクタ等が回復

## スマートフォン

- ・ 構成比は前期の28.4%から 2.7pt減少  
前年同期比25.7%減少
- ・ スマートフォン向けコネクタ部品の減少





## (2)2024年3月期業績予想



- 既存製品金型の固定資産除却損及び、将来の生産計画を精査し認識した減損損失を特別損失に計上  
当期純利益を前回発表予想の250百万円から150百万円に修正
- 車載向けパワー半導体リードフレームは堅調だが、その他の製品群では調整が続く
- 工場稼働率低下に加えて、津軽工場などの先行投資負担もあり、営業利益率は大幅に低下  
新製品量産に向けての金型受注は好調なことから、調整明けには収益は回復に向かうと予想

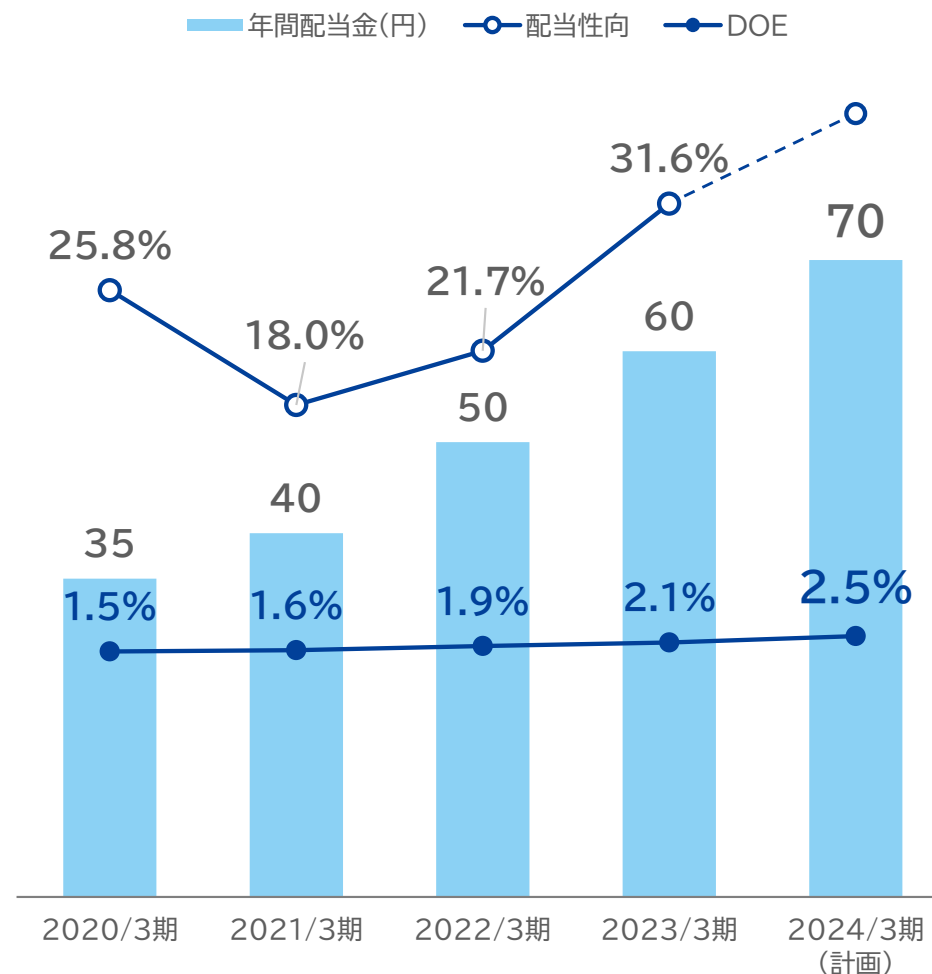
単位:百万円	2023/3期実績		2024/3期予想		期比較	
	実績	売上比(%)	修正予想	売上比(%)	前期比(%)	売上比増減(pt)
売上高	29,265	100.0	25,000	100.0	△14.6	-
売上総利益	4,100	14.0	2,850	11.4	△30.5	△2.6
販管費	2,538	8.7	2,550	10.2	+0.4	+1.5
営業利益	1,561	5.3	300	1.2	△80.8	△4.1
経常利益	1,805	6.2	350	1.4	△80.6	△4.8
当期純利益	1,269	4.3	150	0.6	△88.2	△3.7
1株当たり当期純利益	190.0円	-	22.4円	-	-	-
配当金	60.0円	-	70.0円	-	-	-

- パワー半導体用リードフレームは車載向けは堅調、民生・産業機器向けの在庫調整終了は来期になる見通し
- オプト用リードフレームは北米向け大型ディスプレイなどが低迷
- コネクタ用部品はスマートフォン、ウェアラブル端末向けの調整終了が後倒し、車載向けは回復基調

単位:百万円	2023/3期実績		2024/3期予想		期比較
	実績	構成比(%)	修正予想	構成比(%)	前期比(%)
パワー半導体用 リードフレーム	11,973	40.9	11,500	46.0	△4.0
オプト用 リードフレーム	3,719	12.7	2,500	10.0	△32.8
コネクタ用部品	12,912	44.1	10,500	42.0	△18.7
その他	659	2.3	500	2.0	△24.1
合計	29,265	100.0	25,000	100.0	△14.6

- 2023年5月に配当方針をDOEをベースに変更、期初予想の70円配当を継続

- 配当金・配当性向の推移



## 2024年3月期以降の配当方針

- DOE\*2.5%以上を配当の数値基準とする
- 次期中期経営計画「2nd STEP」でも、最適な自己資本水準や短期的な利益増加の反映方法を総合的に勘案しつつ、増配トレンドを継続する
- 2024年3月期は70円配当を予想 (DOE2.5%)

\* DOE(自己資本配当率) = 年間配当額 / 株主資本

- 2024年3月期は中長期的な成長に向けた仕込み期間と位置付け  
次期中期経営計画「2nd STEP」で「1st STEP」数値目標達成を目指す
- 先行指標の金型受注は急増しており、足下の生産調整後の需要回復に大きな期待

<p>パワー半導体用リードフレーム</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 拡大が予測されているパワー半導体市場に向けクリップボンディング式リードフレームを拡販 ⇒ 中国に加え日本・フィリピンにおいても量産本格化</li> </ul>
<p>オプト用リードフレーム</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 車載/民生向け部品のLED用リードフレーム受注増に対する、増産体制確立（津軽工場を活用予定）</li> </ul>
<p>コネクタ用部品</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5G/6Gに向け、高周波対応のマイクロコネクタによる更なるシェアアップ</li> <li>• 中長期的な成長が見込まれるウェアラブル市場へのマイクロコネクタ拡販</li> </ul>
<p>メッキライン(内製化)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 中国メッキ新工場、津軽工場新メッキラインの量産効果による付加価値率の更なる向上</li> </ul>

## 注意事項

事業の展望、業績予想等の将来の動向にかかる記載につきましては、歴史的事実ではないため、不確定な要素を含んでおります。

現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があることをご了承願います。